

Informations de base	
<p>2018/2947(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué</p> <p>Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Subject</p> <p>3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	ENVI Environnement, climat et sécurité alimentaire		